

具有 10nA 运输模式、高级电源路径管理和控制功能、12 位 ADC 和 LDO 的 BQ25150 500mA 线性充电器

1 特性

- 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
 - 精度为 0.5% 的 I²C 可编程电池稳压电压，范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
 - 可配置的终止电流，支持低至 0.5mA
 - 可耐受 20V 的输入，具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
 - 可编程热负荷曲线。完全可配置的热、温、凉、冷阈值
- 电源路径管理，用于系统供电和电池充电
 - 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
 - 利用高级 I²C 控制，主机可以根据需要断开电池或适配器。
- I²C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
 - 可编程范围为 0.6V 至 3.7V，阶跃为 100mV
- 超低 I_{ddq}，可延长电池寿命
 - 10nA 运输模式电池 I_q
 - 在为系统供电时具有 400nA 的 I_q (PMID 和 VDD 打开)
- 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
 - 支持系统循环通电和硬件重置
- 12 位 ADC
 - 可以对充电电流、电池热敏电阻和电池、输入和系统 (PMID) 电压进行监控
 - 通用 ADC 输入
- 常开 1.8V VDD LDO，支持高达 10mA 的负载
- 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
- 总解决方案尺寸为 12mm²

2 应用

- 耳麦、耳塞和助听器
- 智能手表和健身附件
- 患者监护仪和便携式医疗设备
- 耳戴式设备和助听器

3 说明

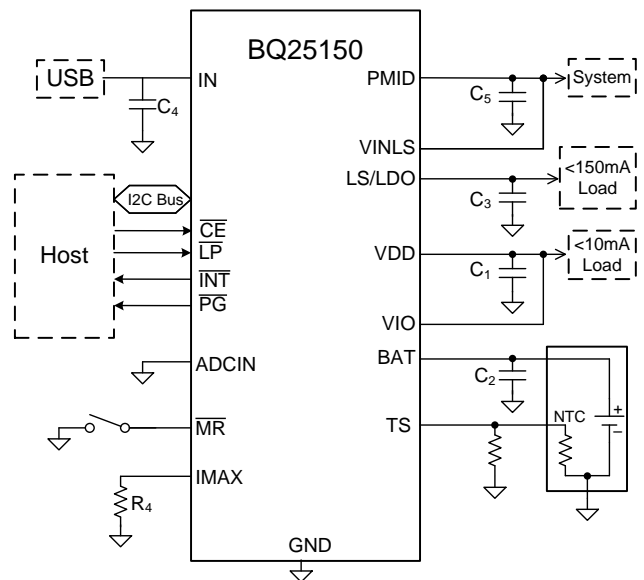
BQ25150 是一款高度集成的电池充电管理 IC，它集成了用于可穿戴设备的最常用功能，即充电器、输出电压轨、用于电池和系统监控的 ADC 以及按钮控制器。

器件信息(1)

器件型号	封装	封装尺寸 (标称值)
BQ25150	DSBGA (20)	2.00mm x 1.60mm

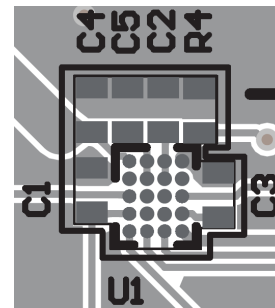
(1) 如需了解所有可用封装，请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

简化原理图



解决方案面积

12 mm² Solution Size



- 0402 Component footprint with 0.2mm pitch
- Pull up and TS resistors not included

4 说明（续）

BQ25150 IC 集成了可以对小型电池进行快速准确充电的线性充电器。该器件支持高达 **500mA** 的充电电流并支持低至 **0.5mA** 的终止电流，从而实现最充分的充电。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电：预充电、恒流和恒压调节。

该器件集成了高级电源路径管理和控制，使该器件可以为系统提供电源，同时甚至能够使用很差的适配器为电池充电。主机还可以通过 **I²C** 控制电源路径，允许它断开输入适配器和/或电池，而无需实际移除它们。单按钮输入无需单独的按钮控制器 **IC**，从而减少了整体解决方案占用空间。按钮输入可用于唤醒功能或重置系统。**12 位 ADC** 可实现精确的电池电压监控，并可用于实现低 **I_q** 监测，以监控电池运行状况。它还可用于使用连接到 **TS** 引脚的热敏电阻以及外部系统信号（通过引脚）来测量电池温度。运行和关断期间的低静态电流有助于实现最长的电池寿命。可通过 **I²C** 接口对输入电流限制、充电电流、**LDO** 输出电压和其他参数进行编程，从而使 **BQ25150** 成为非常灵活的充电解决方案。该器件包含一个基于电压的 **JEITA** 兼容（或标准热/冷）电池组热敏电阻监控输入 (**TS**)，可监控电池温度并自动更改充电参数，从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。还可以通过 **I²C** 对温度阈值进行编程，从而使主机能够自定义热负荷曲线。该充电器针对 **5V USB** 输入进行了优化，具有 **20V** 的绝对最大容差，从而能够承受线路瞬态。该器件还集成了一个用于为无线电或处理器提供静态轨的线性稳压器，可以通过 **I²C** 独立地为其提供电源并对其进行控制。

5 器件和文档支持

5.1 文档支持

5.1.1 相关文档

请参阅如下相关文档：《[BQ25150EVM 用户指南](#)》(SLUUBV0)

5.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 TI.com.cn 上的器件产品文件夹。单击右上角的 [通知我](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

5.3 社区资源

下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [《使用条款》](#)。

TI E2E™ 在线社区 [TI 的工程师对工程师 \(E2E\) 社区](#)。此社区的创建目的在于促进工程师之间的协作。在 e2e.ti.com 中，您可以咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题。

设计支持 [TI 参考设计支持](#) 可帮助您快速查找有帮助的 E2E 论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。

5.4 商标

E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

5.5 静电放电警告



ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

5.6 术语表

[SLYZ022](#) — *TI 术语表*。

这份术语表列出并解释术语、缩写和定义。

6 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此产品说明书的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2018 德州仪器半导体技术（上海）有限公司

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
BQ25150YFPR	ACTIVE	DSBGA	YFP	20	3000	RoHS & Green	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ25150	Samples
BQ25150YFPT	ACTIVE	DSBGA	YFP	20	250	RoHS & Green	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ25150	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

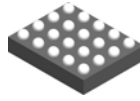
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
BQ25150YFPR	DSBGA	YFP	20	3000	180.0	8.4	1.77	2.17	0.62	4.0	8.0	Q1
BQ25150YFPT	DSBGA	YFP	20	250	180.0	8.4	1.77	2.17	0.62	4.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

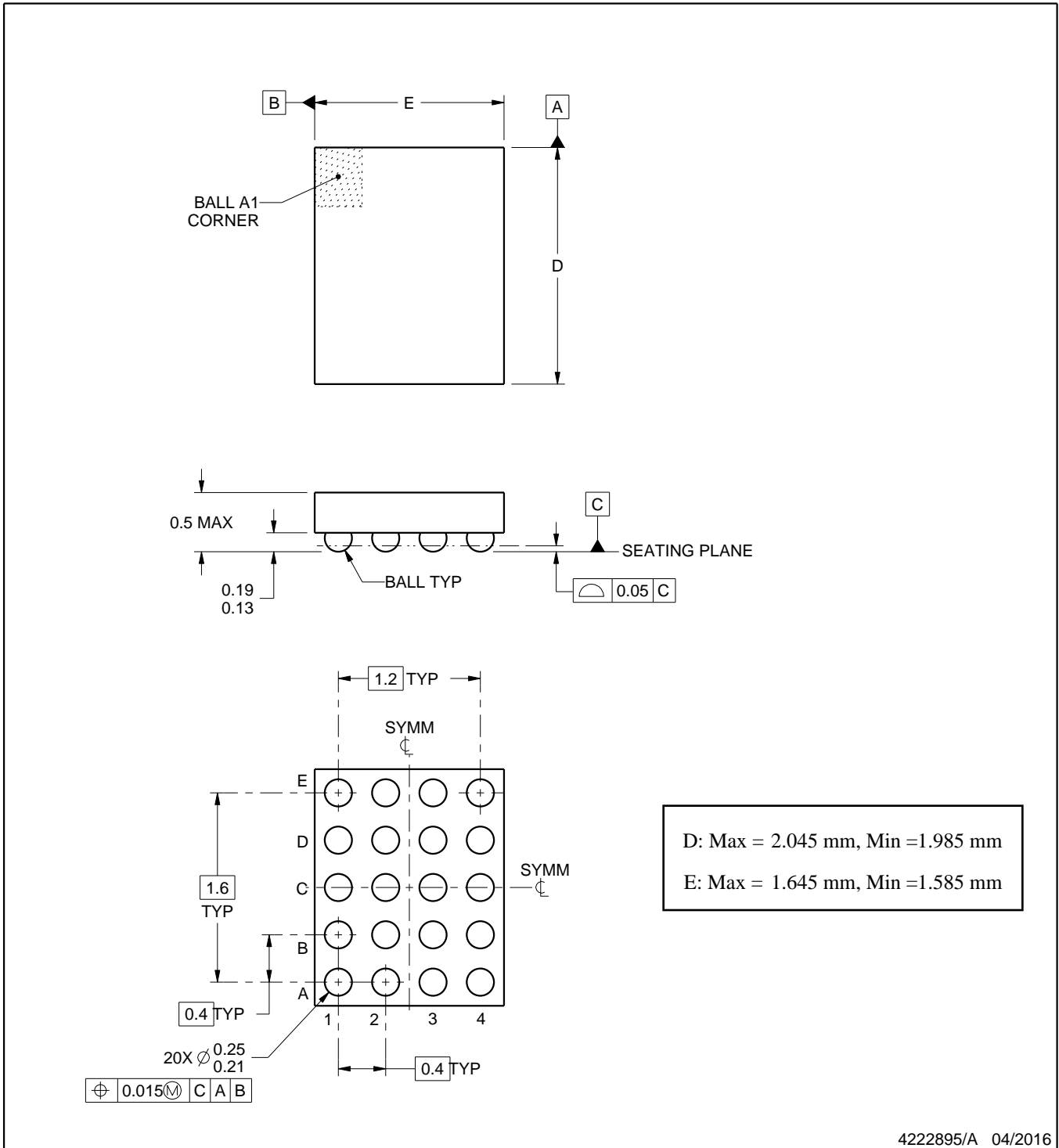
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
BQ25150YFPR	DSBGA	YFP	20	3000	182.0	182.0	20.0
BQ25150YFPT	DSBGA	YFP	20	250	182.0	182.0	20.0

YFP0020



PACKAGE OUTLINE
DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



4222895/A 04/2016

NOTES:

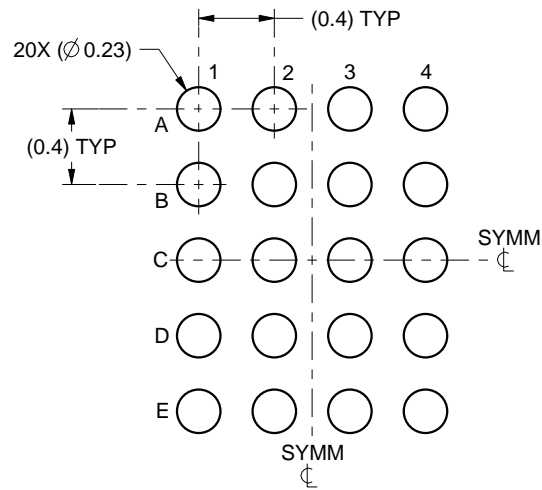
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

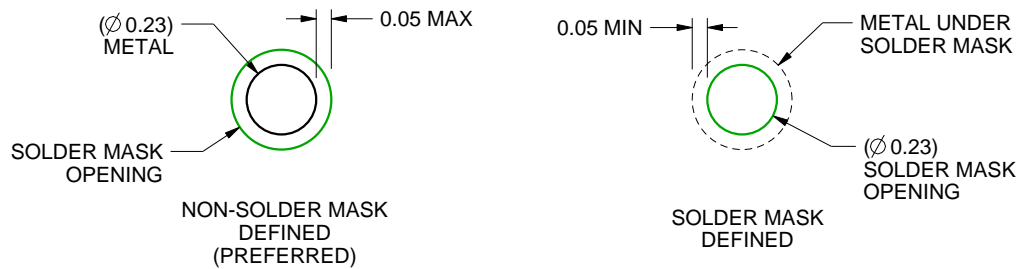
YFP0020

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:25X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4222895/A 04/2016

NOTES: (continued)

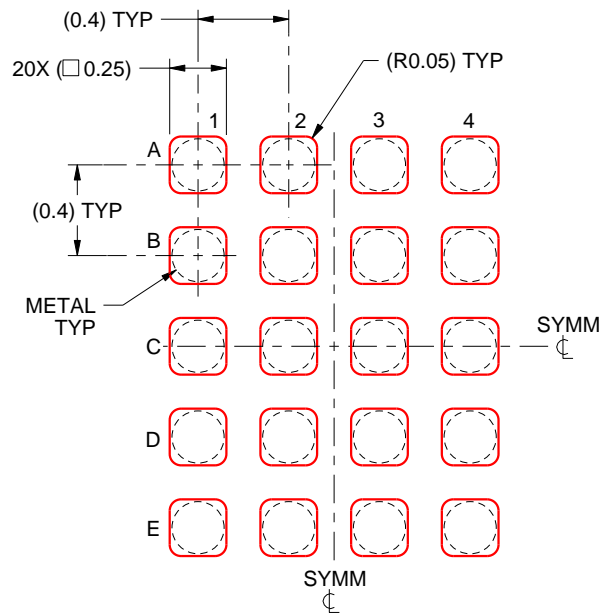
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YFP0020

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:30X

4222895/A 04/2016

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性 & 可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用 TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及 TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对 TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受 TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及 [ti.com.cn](http://www.ti.com.cn) 上或随附 TI 产品提供的其他可适用条款的约束。TI 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2020 德州仪器半导体技术（上海）有限公司